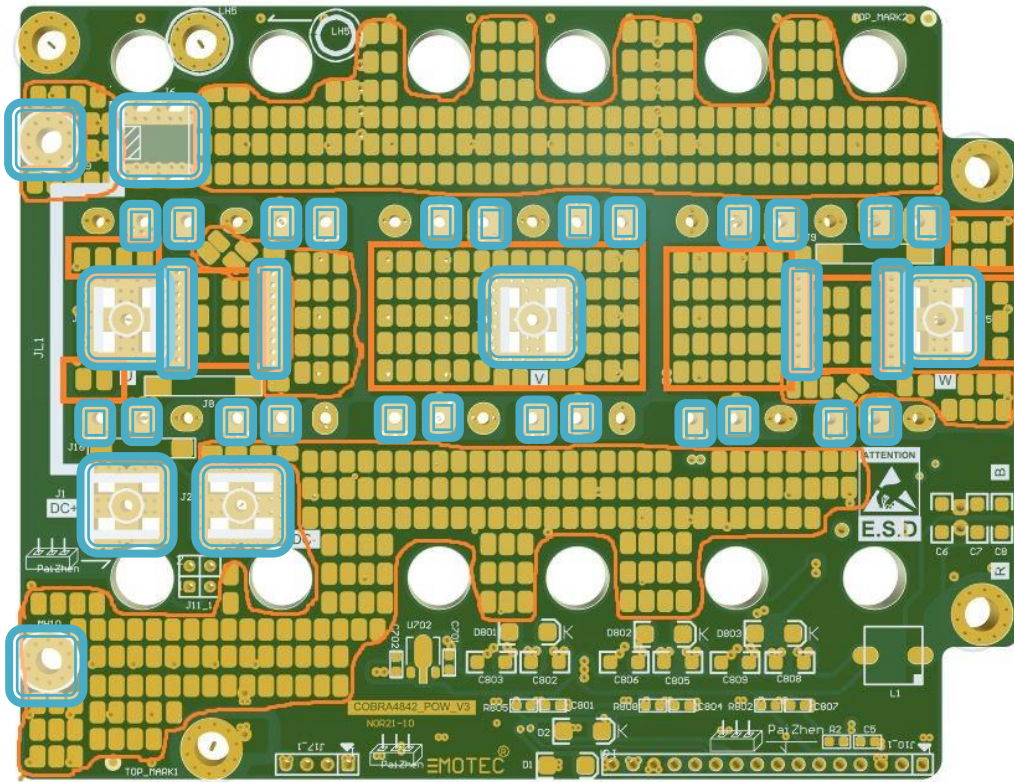




PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4842_POW_V3	焊接	QM0332021102501	V3	1/3	20211025

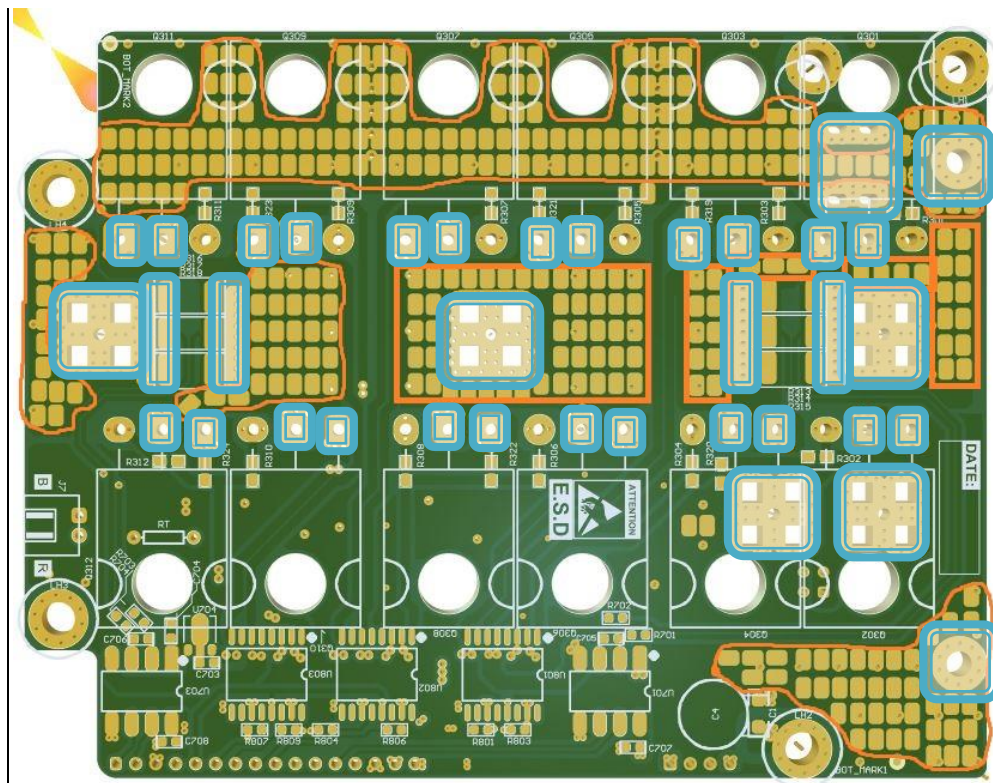
## 1. COBRA4842\_POW\_V3 加锡位置(即除元件焊盘外, 所有裸露焊盘[露铜位置]进行加锡)



### 顶层



- 1)  橙色框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm;
- 2)  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内上下焊锡通透 (灌满焊锡);

### 底层

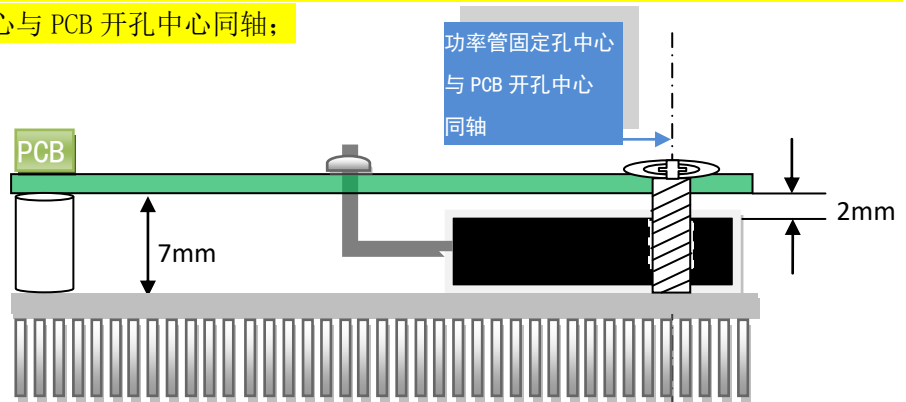


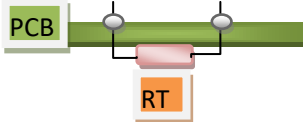
- 1)  橙色框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm;
- 2)  蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔内从底层至顶层注满焊锡;
- 3) J1~J6 端子, 底层加锡焊接, 焊锡熔化后, 电烙铁仍要停留 2~3 秒, 保证焊锡从过孔完全流到板子顶层。

PCB 焊接 工艺要求	产品名称 直流伺服	产品型号 COBRA4842_POW_V3	工序 焊接	文件编号 QM03320211025	版本 V3	页数 2/3	制订时间 20211025
----------------	--------------	--------------------------	----------	-----------------------	----------	-----------	------------------

## 2. 焊接要求

- 1) J1~J6 的 PCB 接线端子，均须垂直于主板落到底焊接，严禁歪斜；
- 2) 功率管 Q301~Q312 共计 12 个（T0-247 封装的管子），管脚直角折弯
  - a) 高度：功率管的下表面（金属部分）距离 PCB 下表面 7mm 焊接；且要求功率管脚顶层和底层双面焊接；
  - b) 焊接后，功率管固定孔中心与 PCB 开孔中心同轴；

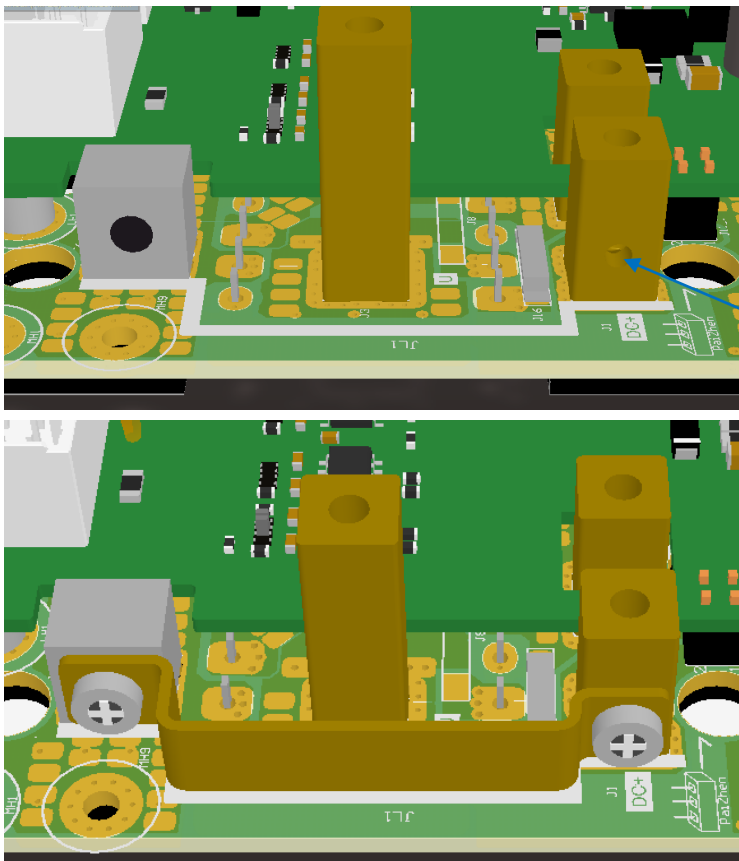


- 3) 温感热敏电阻 RT 紧贴 PCB 的下表面焊接（见右图）
 

### 4) 四方插脚铜柱焊接要求：

- a) J1（DC+）位置的焊接四方插脚铜柱（18\*8\*8mm 带孔），
- b) J2（DC-）位置的焊接四方插脚铜柱（18\*8\*8mm 不带孔），
- c) J3~J5 位置焊接四方插脚铜柱（29\*8\*8mm）

※四方插脚铜柱（带孔）侧面有 M3 的螺纹孔，该孔要面向 DC+ 丝印方向，孔的方向严禁转 90 度焊接，否则无法固定铜排

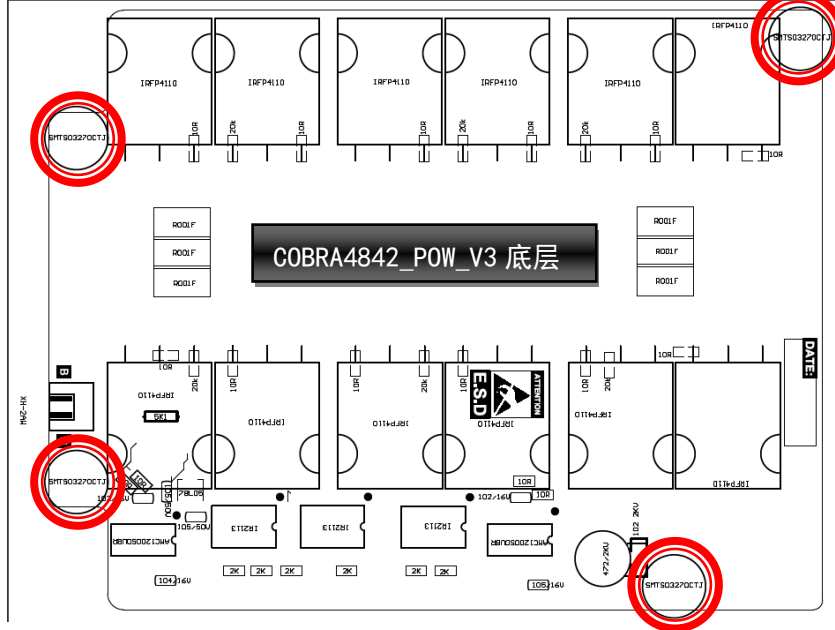
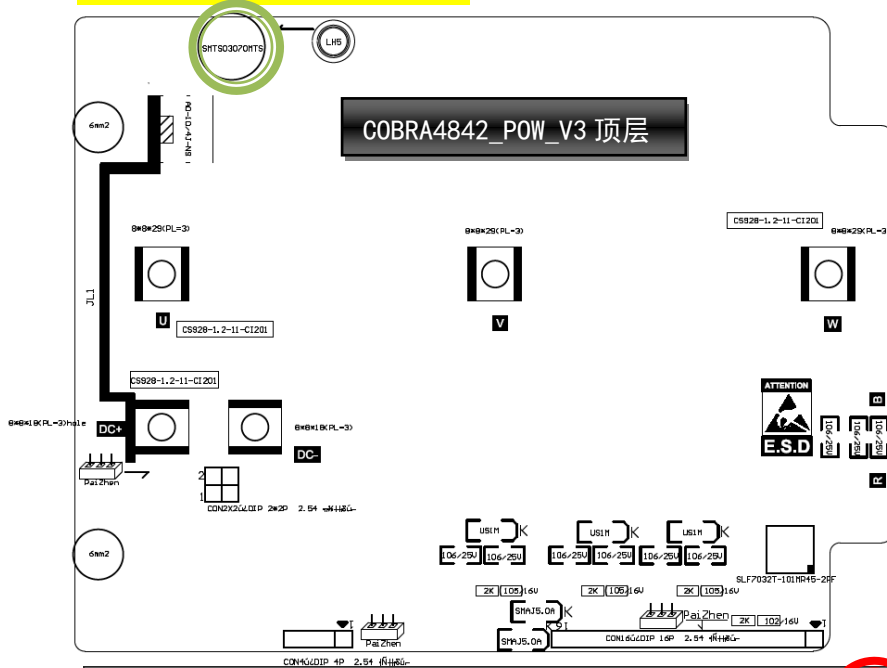


通孔要朝向  
DC+ 丝印方向

PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4842_POW_V3	焊接	QM03320211025	V3	3/3	20211025

5) 贴片螺母焊接要求:

- a) LH5 位置焊接 SMTS03070MTS ( M3\*7 带螺纹支撑柱);
- b) LH1, LH2, LH3, LH4 位置焊接 SMTS03270CTJ ( M3\*7 不带螺纹支撑柱);
- c) 贴片螺母要求落到底焊接, 保证焊接后螺母垂直于 PCB, 同时焊盘圆周上的过孔注满锡 (见下图);
- d) 贴片螺母的顶端不能有沾锡;



- 6) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 7) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 8) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 9) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 10) 手工操作要做防静电处理;
- 11) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 12) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	